## 印制电路板行业规范公告管理办法

(征求意见稿)

#### 第一章 总则

第一条为推动印制电路板产业高端化、绿色化、智能化发展,引导产业加快转型升级,贯彻落实《印制电路板行业规范条件(2025年本)》(以下简称《规范条件》),制定本办法。

第二条 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门(以下统称省级行业主管部门)负责本地区印制电路板企业申请材料的受理、核实和报送工作,监督规范条件执行情况。

工业和信息化部负责全国印制电路板行业规范公告管理工作,组织对企业申请材料进行复核、抽检、公示及公告, 发布印制电路板行业规范公告名单并实施动态管理。

第三条 本办法适用于中华人民共和国境内(台湾、香港、澳门地区除外)所有类型的印制电路板生产企业,不涉及专用设备和专用材料(覆铜板、半固化粘结片、铜箔、油墨等)的制造企业。

#### 第二章 申请与审核

第四条 申请公告的企业应具备以下条件:

- (一)具有独立法人资格;
- (二)符合国家产业政策和相关发展规划;
- (三)符合《规范条件》要求;
- (四)遵守国家法律法规,无重大违法行为。

第五条 符合本办法第四条所列条件的企业可自愿向所 在地省级行业主管部门提出公告申请,填报《印制电路板行 业规范公告申请书》(格式附后)。

申请企业应当对申请材料真实性负责。

第六条 申请企业承诺具有企业相关基本资质文件等材料,包括:

营业执照副本,项目备案或核准文件,项目用地权证或 用地审批文件,项目环评批复文件、环保竣工验收文件,财 务审计报告、企业申报印制电路产品的工艺流程文件、证明 产品加工能力的第三方检测报告及产品制程文件、有害物质 限制使用符合性文件或报告、清洁生产水平证明(HJ 450 三 级及以上)、质量管理体系认证证书、专利证书及其他有关 材料。

**第七条** 省级行业主管部门自收到申请材料起 20 个工作 日内,将核实且符合规定的申请材料报送工业和信息化部。

第八条 工业和信息化部收到企业申请材料之日起60个

工作日内,组织有关行业机构和专家,采用材料审查和现场核实的方式完成复核。符合规范条件的企业名单,在工业和信息化部网站上进行公示;经公示无异议的企业,以工业和信息化部公告形式予以公布。

第九条 工业和信息化部在受理和审核过程中可以对申请企业有关情况进行实地查验,查验工作应当指派两名以上工作人员进行。申请企业应当配合查验工作。

#### 第三章 监督与管理

第十条 进入公告名单的印制电路板企业(以下简称公告企业)应按照《规范条件》的要求组织生产经营活动,并对照规范条件要求开展自查,每年3月31日前向工业和信息化部提交上年度自查报告。

自查报告是公告企业执行《规范条件》情况的重要依据,包括以下主要内容:企业生产经营情况、产品进出口情况;质量管理、节能降耗、环境保护、安全生产等制度建设及运行情况;法人代表、股权或资本金、主要产品品种及生产能力等变更情况。

- 第十一条 公告企业名称发生变化时,需及时提出变更申请,经省级行业主管部门核实后,报送工业和信息化部。
- 第十二条 公告企业出现下列情况之一时,需重新申请公告,并撤销其原公告,经省级行业主管部门核实后,报送

工业和信息化部:企业合并、分立或兼并重组,企业产能产 线发生较大变化,企业搬迁新址,其他重大变化。

- 第十三条 省级行业主管部门对公告企业保持规范条件情况进行监督核实。每年4月30日前将上年度监督结果报送工业和信息化部。
- 第十四条 欢迎和鼓励社会监督。任何单位或个人发现 正在申请规范公告或已公告的印制电路板企业有不符合本 办法有关规定或《规范条件》有关要求的,可向各级工业和 信息化主管部门举报。
- 第十五条 公告企业有下列情况之一的,省级行业主管部门责令其限期整改。
  - (一)不能保持《规范条件》要求的;
  - (二)未按时报送自查材料;
  - (三)填报资料有弄虚作假行为的;
  - (四)拒绝接受监督检查的;
  - (五)发生重大安全事故、重大环境污染事故的;
  - (六)列入严重违法失信企业名单;
  - (七)违反法律、法规和国家产业政策规定的。

拒不整改、整改不合格、发生重大质量事故或者停产超过1年的,工业和信息化部撤销其公告资格。工业和信息化部撤销其公告资格。工业和信息化部撤销企业公告资格时,应提前告知有关企业,听取企业的陈述和申辩,视情况组织专家进行论证。

被撤销公告资格的企业,其申报材料两年内不予受理。

第十六条 工业和信息化部组织或委托第三方检测机构,对公告企业产品进行抽查。抽查不合格的企业,将通报并责令其予以整改;连续两次抽查不合格的企业,视为不能保持《规范条件》要求。

#### 第四章 保障措施

第十七条 工业和信息化部会同有关部门,加强《规范条件》公告名单的协同联动,充分利用中央和地方相关渠道,与相关政策措施形成合力。

#### 第五章 附则

第十八条 本办法自 2025 年 X 月 X 日起施行,由工业和信息化部负责解释。《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》(工业和信息化部公告 2018 年第 71 号)同时废止。

附:印制电路板行业规范公告申请书

# 印制电路板行业规范公告申请书

| 企业名称(加盖公章): |       |
|-------------|-------|
| 联系地址及邮编:    |       |
|             |       |
| 联系人 1:      | 职 务:  |
| 手 机:        | 传 真:  |
| 办公电话:       | 电子邮箱: |
| 联系人 2:      | 职 务:  |
| 手 机:        | 传 真:  |
| 办公电话:       | 电子邮箱: |

填表日期: \_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 填写须知

- 1.填写申请书应确保所填资料真实、准确、客观,如有 伪造、编造、变造和隐瞒等虚假内容,所产生的一切后果由 申报单位承担。
- 2.申报单位仅适用于印制电路板制造企事业单位,不涉及专用设备和专用材料(覆铜板、半固化粘结片、铜箔、油墨等)的制造企业。
- 3.申报单位同时生产多种类型印制电路板产品时,应注明每种类型产品信息,或以主营产品进行申报。
- 4.申请书需同时提交纸质版和电子版,纸质版需手写部分应用黑色钢笔以正楷字填写,字迹清楚。
  - 5.填报项目(含表格)页面不足时,可另附页面。
  - 6.请在申请书所选项目对应的"□"内打"√"。
- 7.申请书内容不含子公司或控股公司,申请企业如有子公司或控股公司,每个子公司或控股公司均应单独填写申请书,按属地原则自行报送。

## 一、企业基本情况

| 1   |                                     | 菅□  |
|---|-------------------------------------|---|
| 有限责任□ 股份  | 有限□ 股份合作制□                          | 个人独资□   |
| (填写前3名股东名称及持股比例)                                      |                                     |   |
| 单、双面板□ 多层板□ HDI□ 挠性板□ 刚挠结合板□ IC 载板□ 金属基板、样板、小批量板、特色板□ |                                     |   |
| 是□ 否□   | 采用全印制电子技术<br>制造工艺项目                 | 是□ 否□   |
| 是□ 否□   | 玻璃基板工艺项目                            | 是□ 否□   |
|   | 上市地点及代码                             |   |
| 1.<br>2.  |                                     |   |
|   | 开工建设日期                              |   |
|   | 统一社会信用代码                            |   |
|   | 所在产业园区                              |   |
|   | 其中技术人员人数                            |   |
|   | 上年度销售收入                             |   |
|   | 上年度研发投入占比                           |   |
| 省级及以上独立研发   | -<br>机构或技术中心□                       | 高新技术企业□   |
| 发明专利<br>实用新型专利<br>其他                                  | 项<br>项<br>项                         |   |
|   |                                     |   |
|   |                                     |   |
|   |                                     |   |
|   |                                     |   |
|   |                                     |   |
|   | 股份制□ 港澳台 有限责任□ 股份 (填写前 3 名股东名 单、双板□ | 股份制□ 港澳台投资□ 外商投资□ 有限责任□ 股份有限□ 股份合作制□ (填写前 3 名股东名称及持股比例)  □ 单、双面板□ 多层板□ HDI□ 挠性板□ IC 载板□ 金属基板、样板、小批量板、 |

| 工艺路线(附流程图) |  |
|------------|--|
| 备注(可另附页):  |  |

### 二、项目建设情况

|            | 投产日期                      |       |                             | 产品名称                    | <b>火</b> 、生产线           | 板<br>板                   |                          |
|------------|---------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            | 总投资                       |       | 万元                          | 设备                      | -投入                     | 万                        | 元                        |
|            | 产品类型                      | 占比(%) | 人均产值<br>(万元人<br>民币/年•<br>人) | 上一年<br>产能<br>(万平<br>方米) | 上一年<br>产量<br>(万平<br>方米) | 预计本年<br>产能<br>(万平方<br>米) | 预计本年<br>产量<br>(万平方<br>米) |
|            | 单、双面板□                    |       |                             |                         |                         |                          |                          |
| <b>企</b> 口 | 多层板□                      |       |                             |                         |                         |                          |                          |
| 产品类型       | HDI □                     |       |                             |                         |                         |                          |                          |
| 7.1        | 挠性板□                      |       |                             |                         |                         |                          |                          |
|            | 刚挠<br>结合板□                |       |                             |                         |                         |                          |                          |
|            | IC 载板□                    |       |                             |                         |                         |                          |                          |
|            | 金属基板、样<br>板、小批量<br>板、特色板□ |       |                             |                         |                         |                          |                          |

备注(可另附页):如属于航天、航空、军工等行业用印制电路板产品的生产企业,或采用全印制电子技术制造、埋置元器件、玻璃基板工艺的项目等,需详细描述产品特点、市场份额等信息)

### 三、关键技术指标和加工能力

| 最小线宽/间距:μm/μm,<br>最小孔径:μm,<br>单、双面板□ 最小阻焊开窗: μm, |        |            |
|--|--------|------------|
| 最小阻焊桥:;<br>最小孔厚径比:;                              | 单、双面板□ | 最小阻焊开窗:µm, |

| 多层板口                                      | 总层数:层,<br>最小线宽/间距:μm/μm,<br>最小孔径:μm,<br>最小阻焊开窗:μm,<br>最小阻焊桥:μm,<br>最小孔厚径比:,<br>层间对准度: μm,<br>钻孔位置精度:μm; |  |  |
|---|---|--|--|
| HDI □                                     | <ul> <li>所数:</li></ul>  |  |  |
| 挠性板□                                      | 最小线宽/间距:µm/µm,<br>最小孔径:µm,<br>最小覆盖膜开窗:µm;   |  |  |
| 刚-挠结合板□                                   | 总层数:层,<br>挠性层数:层,<br>最小线宽/间距:μm/μm,<br>最小阻焊开窗:μm,<br>最小阻焊桥:μm,<br>最小钻孔厚径比:;                             |  |  |
| IC 载板□                                    | 总层数:层,<br>最小线宽/间距:μm/μm,<br>最小孔径:μm,<br>最小孔厚径比:,<br>层间对准度:μm。   |  |  |
| 备注(可另附页):需提供可证明满足以上要求的、检测日期为近两年内的第三方检测报告。 |   |  |  |

### 四、质量管理和知识产权

| 是否建立质量管理体系   | 是□ | 否□  |
|--|----|-----|
| 是否通过质量管理体系认证   | 是□ | 否□  |
| 是否建立产品可追溯制度  | 是□ | 否□  |
| <br>  是否符合相关国家或行业标准要求  | 是□ | 标准: |
| ACE NE INVENTAGE AND ACTION OF THE PROPERTY OF | 否□ |     |
| 是否配备质量检验部门和专职检验人员  | 是□ | 否□  |
| 产品质量是否满足相关现行国家或行业标准  | 是□ | 标准: |
| ) 即灰里足日极尺相入光打国家或打亚你住   | 否□ |     |
| 是否参与印制电路板领域国家标准、行业标准制修订和国际标  | 是□ | 标准: |
| 准化活动   | 否□ |     |
| 是否建立测量管理体系   | 是□ | 否□  |
| 是否建立完善的知识产权合规管理体系  | 是□ | 否□  |
| 是否具有电测试、尺寸测量、自动光学检测等检测能力   | 是□ | 否□  |
| 是否配备高低温循环、温度冲击、湿热等环境适应性试验能力  | 是□ | 否□  |
| 是否通过测量管理体系认证   | 是口 | 否□  |
| 备注:  |    |     |

### 五、智能制造

| 是否使用自动化生产制造设备               | 是□ 否□               |
|-----------------------------|---------------------|
| 是否使用网络化的生产制造设备              | 是□ 否□               |
| 是否使用信息化系统                   | MES□ ERP□ WMS□ SRM□ |
| <b>是古</b> 医八 旧心 旧本 乳        | 其它□ 否□              |
| <br>  是否开展智能制造能力成熟度评估       | 是□ 水平:              |
| (文百月·成有 配 柯 逗 配 刀 风 然 及 耳 的 | 否□                  |
| 是否具备个性化定制生产能力               | 是□ 否□               |
| 自动化、信息化应用效果*                |                     |
| 是否为智能制造试点示范企业               | 国家级□ 省级□ 否□         |
| 备注: *简要说明自动化、信息化应用在运营成本     | 、产品生产周期、生产效率、不良品率、  |
| 能源利用率等方面的效果。                |                     |

## 六、绿色制造

|                       | 对应 HJ450-2008 指标水平, 达到: |
|-----------------------|-------------------------|
|                       | 一级□ 二级□ 三级□ 否□          |
| 是否持续开展清洁生产审核,清洁生产指标水平 | 其中:废水产生量                |
| 情况                    | 一级□ 二级□                 |
|                       | 其中: 金属铜回收率              |
|                       | 一级□ 二级□ 三级□ 否□          |
| 产品是否符合《电器电子产品有害物质限制使用 | 是□ 否□                   |
| 管理办法》要求               | 走口   省口                 |
| 产品是否符合《环境保护综合名录》要求    | 是□ 否□                   |
| 产品是否通过电器电子产品有害物质限制使用认 | 是□ 否□                   |
| 证评价                   | 走口   省口                 |
|                       | 绿色产品□    绿色工厂□          |
| 是否通过绿色制造认证评价          | 绿色园区内企业□ 绿色供应链企业□       |
|                       | 否□                      |
| 是否承担或参与绿色制造系统集成项目     | 承担□ 参与□ 否□              |
| 是否承担或参与绿色制造标准制修订      | 承担□ 参与□ 否□              |
| 备注:                   |                         |

## 七、节能节地、资源综合利用及环境保护

| 是否符合国家出台的土地使用标准      | 是□ 否□      |
|----------------------|------------|
| 是否使用严重污染环境的设备或生产工艺   | 是□ 否□      |
| 是否使用国家明令淘汰的用能设备或生产工艺 | 是□ 否□      |
| 是否设立专职节能岗位           | 是□ 否□      |
| 是否制定产品单耗指标和能耗台帐      | 是□ 否□      |
| 是否承担或参与节能标准制修订       | 承担□ 参与□ 否□ |
| 是否通过环境影响评价审批         | 是□ 否□      |
| 是否进行项目竣工环保验收         | 是□ 否□      |
| 企业排污许可证号             | 是□ 否□      |
| 污染物排放总量是否符合批复总量要求    | 是□ 否□      |
| 工业固体废物是否依法分类收集、贮存、处置 | 是□ 否□      |
| 或综合利用                |            |
| 危险废物是否按照国家有关规定利用处置   | 是□ 否□      |
| 涉及有毒有害物质设备设施是否按照国家有关 |            |
| 规定建设安装相关装置           |            |
| 是否建设污染物在线监测系统,实时监控污染 |            |
| 物排放情况。               |            |
| 是否制定突发环境事件应急预案       | 是□ 否□      |
| 是否通过环境管理体系认证         | 是□ 否□      |
|                      |            |

| 备注:                         |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 近两年是否发生环境事故以及整改情况           | 是□(发生时间:;<br>已整改通过□ 未整改或整改未通过□)<br>否□ |
| 近两年是否发生过排放污染物监测结果超标情况以及整改情况 | 是□(发生时间:;<br>已整改通过□ 未整改或整改未通过□)<br>否□ |

### 八、安全生产和职业卫生

| 是否开展安全生产标准化建设并达到三级及以上 | 是□ 否□ |
|-----------------------|-------|
| 是否依法进行安全生产评价          | 是□ 否□ |
| 是否建立危险化学品管理制度         | 是□ 否□ |
| 是否通过安全设施验收            | 是□ 否□ |
| 是否制定生产安全事故应急救援预案      | 是□ 否□ |
| 近两年是否发生安全责任事故         | 是□ 否□ |
| 是否通过职业健康安全管理体系认证      | 是□ 否□ |
| 是否依法进行职业病危害评价         | 是□ 否□ |
| 是否通过职业病防护设施验收         | 是□ 否□ |
| 是否制定职业病危害事故应急救援预案     | 是□ 否□ |
| 近两年是否发生职业病危害事故        | 是□ 否□ |
| 备注:                   |       |

## 九、社会责任

| 是否依法纳税                    | 是□ 否□      |  |
|---------------------------|------------|--|
| 是否为从业人员按时足额缴纳相关保险费用(五险一金) | 是□ 否□      |  |
| 是否参与扶贫事业                  | 是□ 否□      |  |
| 是否是扶贫龙头企业                 | 省级□ 市级□ 否□ |  |
| 是否推行社会责任报告制度,制定企业社会责任规范   | 是□ 否□      |  |
| 备注:                       |            |  |

## 十、省级行业主管部门意见

| 申请企业名称       |   |           |              |    |        |
|--------------|---|-----------|--------------|----|--------|
| 是否符合《印制电路板行业 |   | 是□        |              | 否□ |        |
| 规范条件》要求      |   | <b>走口</b> |              |    |        |
| 省级行业主管部门意见:  |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
|              |   |           |              |    |        |
| 负责人签名        | : | (单位公章)    |              |    |        |
|              |   |           | 年            | 月  | 日      |
| 经办人及联系电话     |   |           | <del>T</del> | 71 | i<br>— |
|              |   |           |              |    |        |